

KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KÄYTTÖ KIELLETTY

1. Kerta- ja jatkuvatoimiset höyrystyslähteet. Millaisia ne ovat ja miten ne toimivat.

2. Rf-sputteroinnin periaate ja käyttö.

3. Millaisiin tarkoituksiin PVD-pinnoitusprosesseissa voidaan hyödyntää kaasun ionisoitumista eli hehkupurkausta (glow discharge)?

4. Reaktiivisella sputteroinnilla valmistettavat pinnoitemateriaalit. Miten pinnoitteen valmistaminen tapahtuu ko. menetelmällä? Keskeiset erot muihin sputterointimenetelmiin.

5. CVD-laitteistojen rakenneosat ja niiden tehtävät koko prosessin kannalta.

6. PVD-pinnoitteiden rakenteille määritetyt vyöhykemallit. Selitä vyöhykkeiden erot ja miten ne vaikuttavat pinnoitteiden ominaisuuksiin.